

第5章 FPGA设计和硬件描述语言

第一讲 可编程逻辑器件和FPGA设计

第二讲 HDL概述

第三讲 Verilog语言简介

第四讲 Verilog建模方式

第五讲 Verilog代码实例

(除存储器基本概念外，本章其他内容不作要求)

第一讲 可编程逻辑器件和FPGA设计

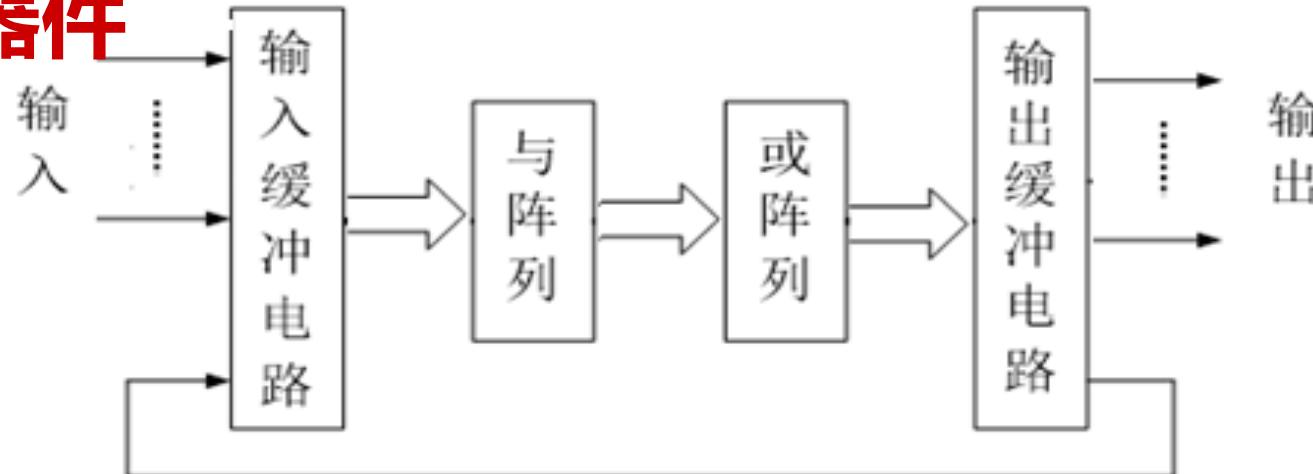
- ◆ 可编程逻辑器件
- ◆ 存储器阵列
- ◆ FPGA设计概述
- ◆ 专用集成电路

1 可编程逻辑器件和FPGA设计

- ◆ 固定逻辑标准芯片（如74系列芯片）曾被广泛使用
- ◆ 但固定逻辑芯片**功能单一**，不能随电路设计的需求而任意改变
- ◆ 固定逻辑芯片逐渐被**可编程逻辑器件（Programmable Logic Device, PLD）取代**

(*) 1.1 PLD器件

◆ PLD结构框图



◆ PLD中基本电路符号

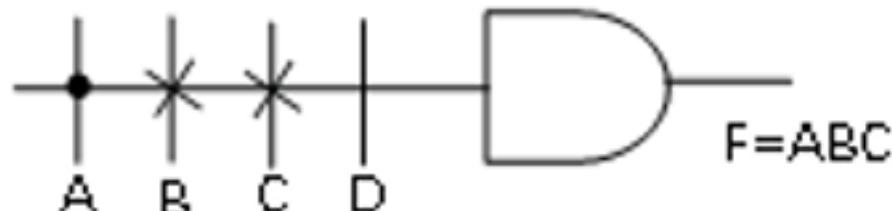
互补缓冲器



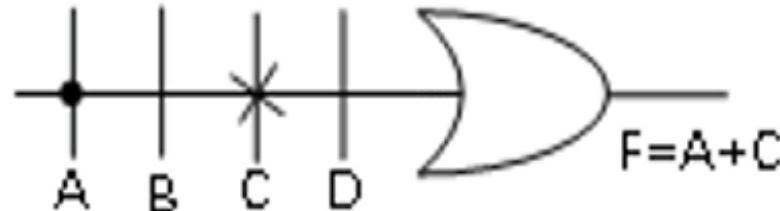
阵列连线



与阵列表示（与门仅示意与阵列）



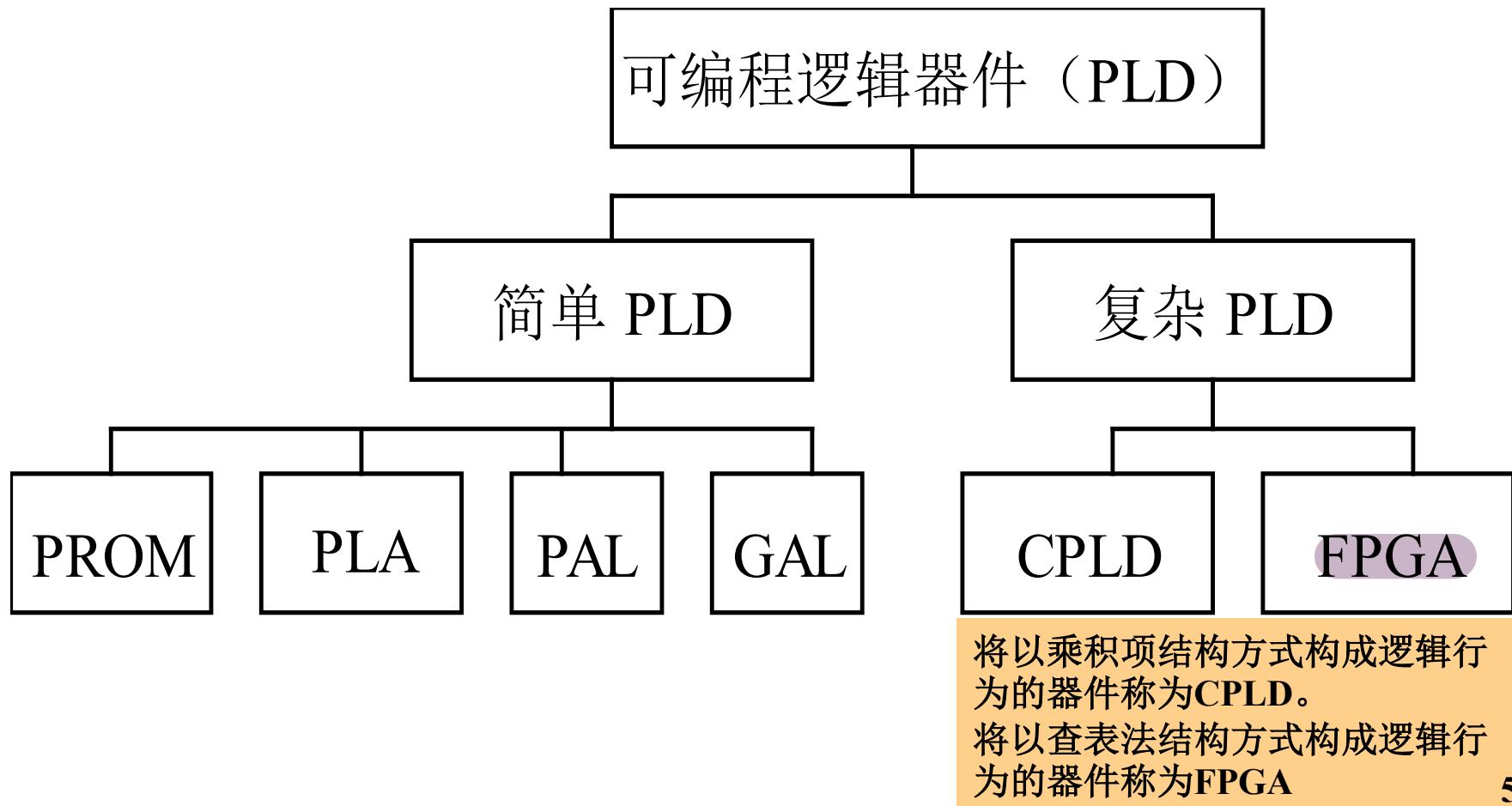
或阵列表示（或门仅示意或阵列）



1.1 PLD分类

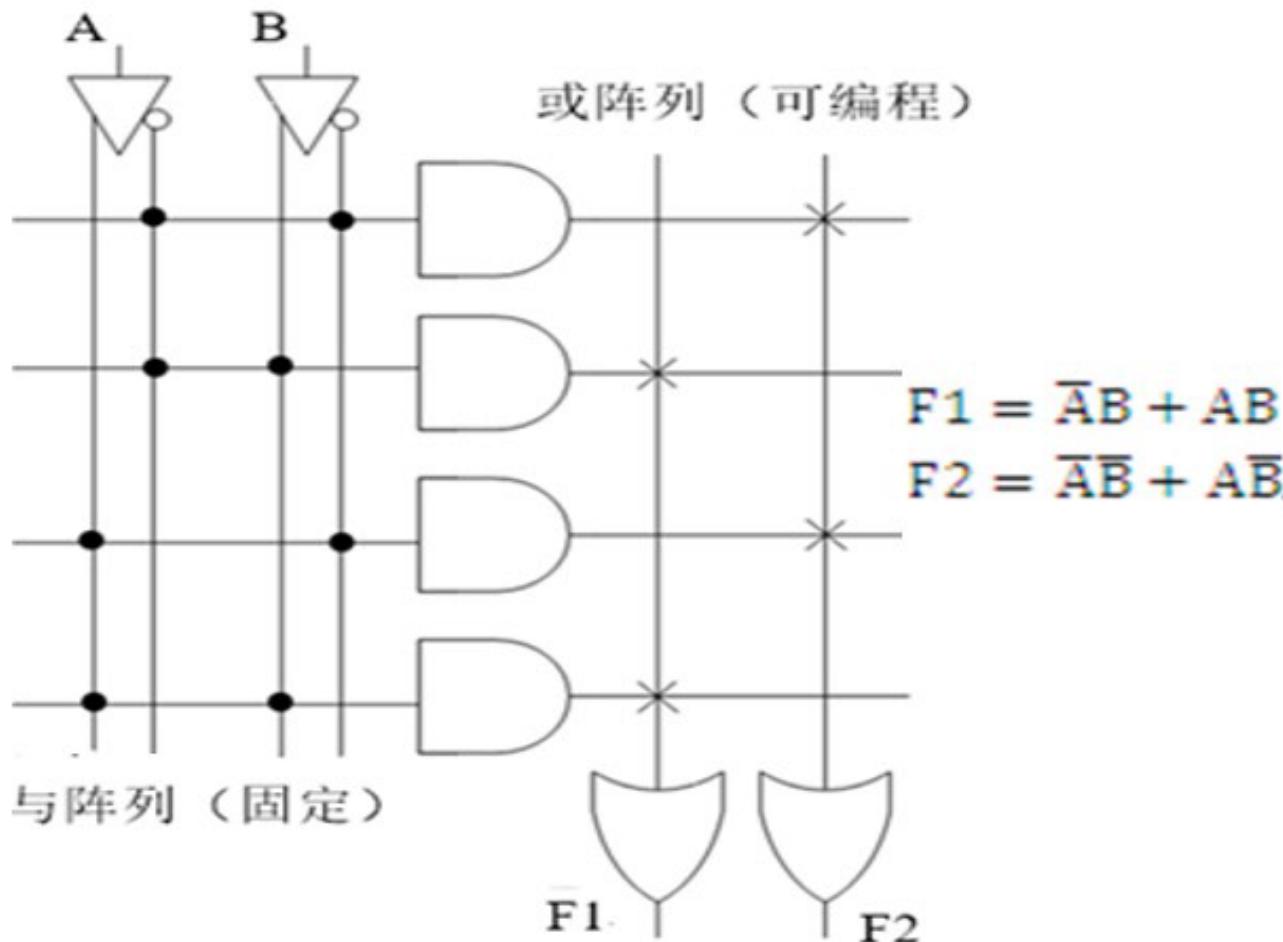
简单PLD：逻辑门数在500门以下

复杂PLD：集成度高，逻辑门数在500门以上



(*) 1.1 PLD器件——PROM

◆ 可编程只读存储器 (Programmable Read Only Memory, PROM) 是一种与阵列固定、或阵列可编程的简单PLD。

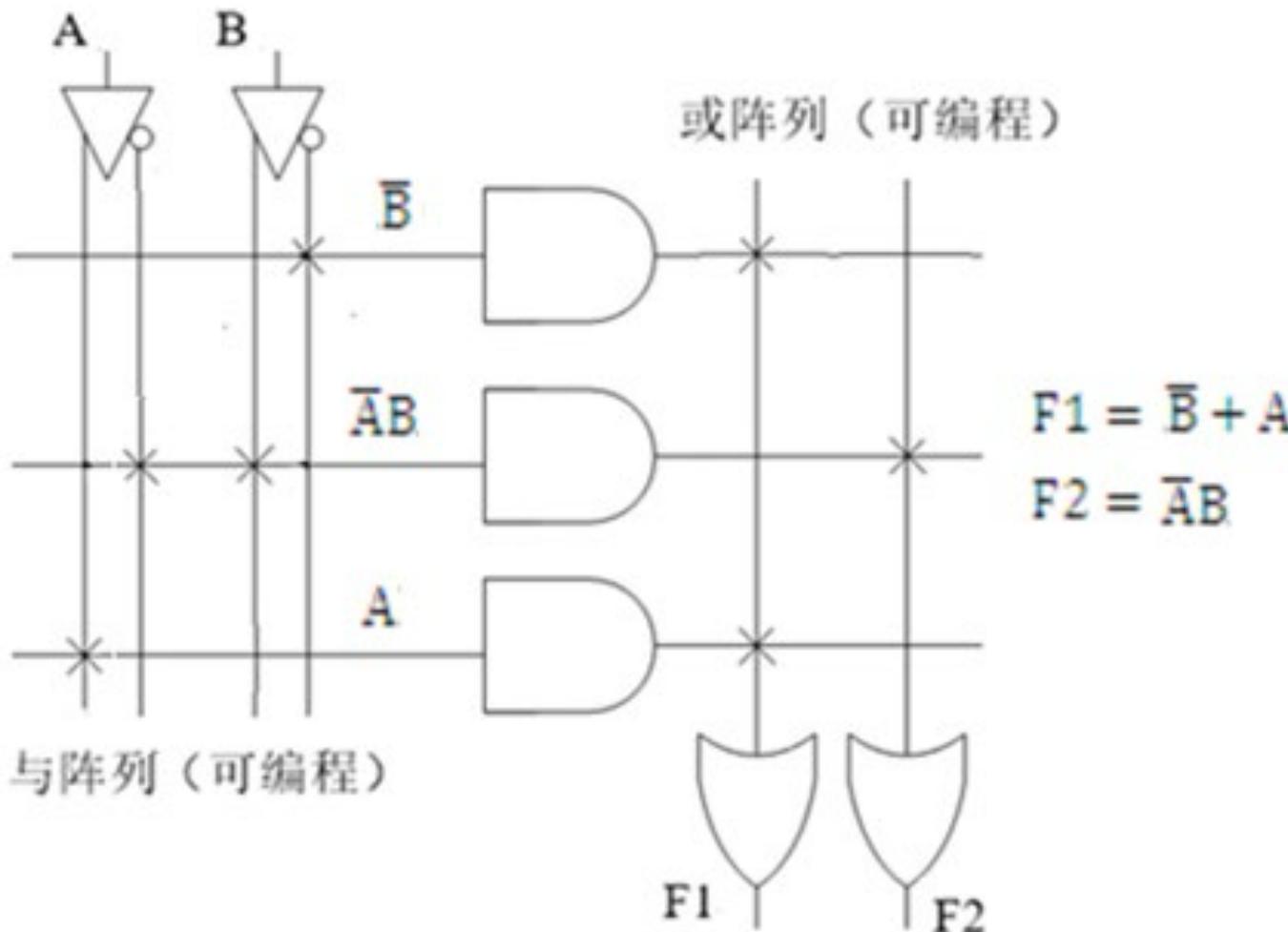


任何逻辑函数转换成标准与-或表达式后，可用PROM来实现

与阵列的水平线输出对应标准与-或表达式中的标准乘积项，即最小项。

(*) 1.1 PLD器件——PLA

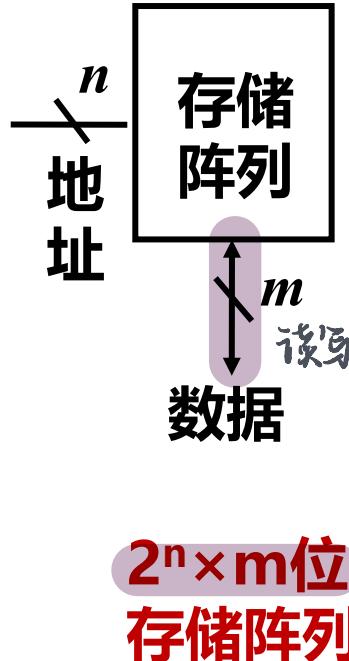
- ◆ 可编程逻辑阵列（Programmable Logic Array, PLA）是一种与阵列、或阵列都可编程的逻辑阵列。



无须像PROM那样将逻辑函数转换成标准与-或表达式，而只要化简成最简与-或表达式即可，可节省编程资源。

1.2 存储器阵列

- ◆ 存储器可用来存储数字电路中的数据。
 - 寄存器（由触发器构成）用来存储少量数据，速度快
 - 存储器阵列用来存储大量数据，速度比寄存器慢
- ◆ 在CPLD和FPGA芯片中通常会提供片内存储器阵列
- ◆ 存储器阵列中每位数据对应一个记忆单元（cell），称为存储元



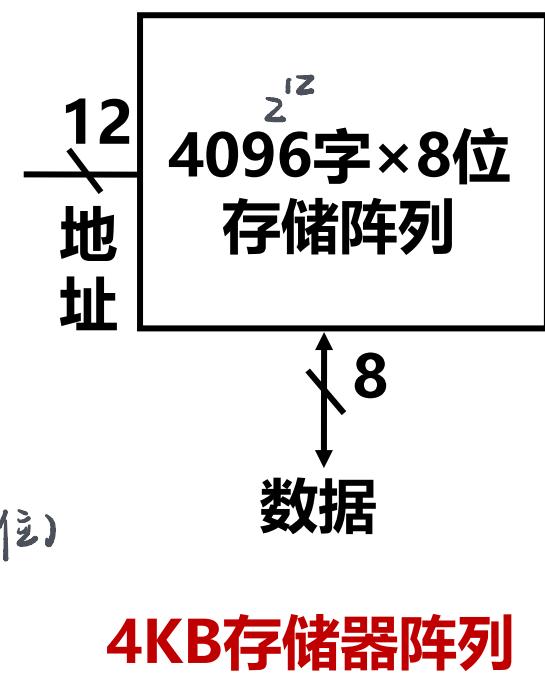
000	0	1	0	0
001	0	0	1	1
010	0	1	0	1
011	1	0	1	1
100	1	1	0	0
101	1	0	1	1
110	0	1	1	0
111	1	0	0	0

地址

该页

8×4位存储器阵列

This diagram illustrates an 8x4 bit memory array. It shows a 4x8 grid of binary digits. The columns are labeled 000 through 111 under the heading "地址" (Address). The rows are labeled 0 through 7 under the heading "该页" (Page). The entire array is labeled "8×4位存储器阵列" (8x4 bit Memory Array).



1.2 存储器阵列——ROM, RAM

按功能可分为：只读存储器(Read-only Memory, ROM)和随机存取存储器(Random-access Memory, RAM)

- ROM属于非易失性存储器，即使电源断电，ROM中存储的数据也不会消失（例如存放BIOS自检启动程序的地方）。根据工艺的不同，分为：

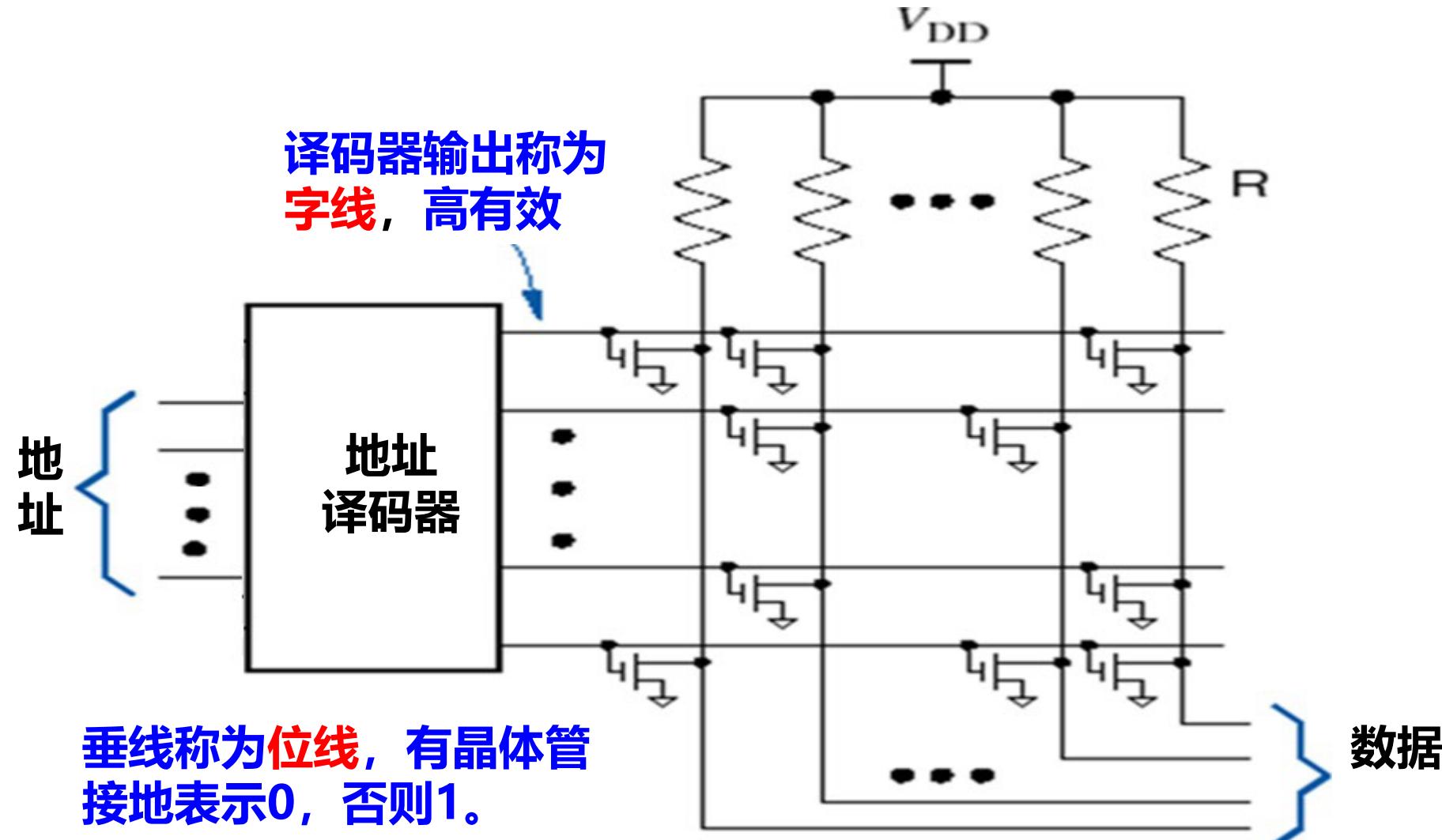
- 掩膜只读存储器MROM（信息固定）
- 一次可编程只读存储器PROM（半成品，可编程）
- 光擦除可编程只读存储器EPROM（紫外线全部擦除）
- 电擦除可编程只读存储器EEPROM（E²PROM）
(电擦除个别字，再重新改写)

- RAM属于易失性存储器，一旦电源断电，RAM中存储的数据就消失。

- 静态RAM (Static RAM, SRAM)
- 动态RAM (Dynamic RAM, DRAM)

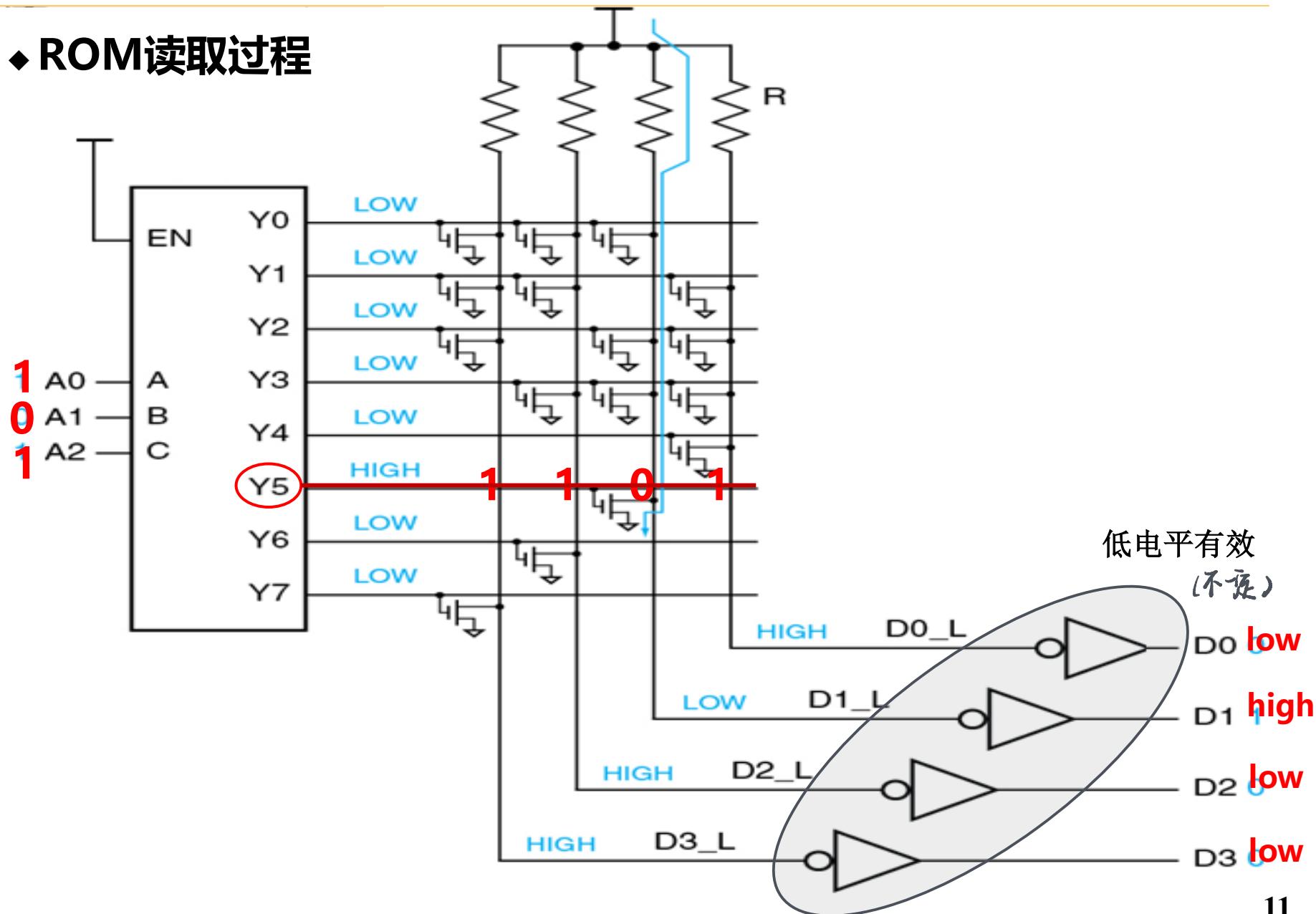
(*) 1.2 ROM

- ◆ ROM存储阵列根据MOS晶体管的有无来区分存储0和1
- ◆ 不同类型的ROM，主要区别在于MOS晶体管的特性不同



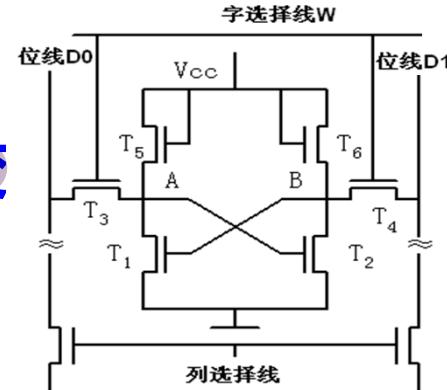
(*) 1.2 ROM读取

◆ ROM读取过程

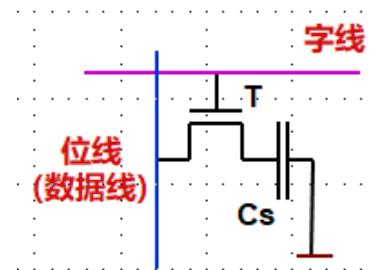


1.2 SRAM 和 DRAM

- ◆ 静态存储器SRAM：6个MOS晶体管
- ◆ 只要保持电源，存储单元中存放数据就保持不变
- ◆ 缺点：器件多，价格高、功耗大、集成度低。
- ◆ 优点：读写速度快、无需刷新。

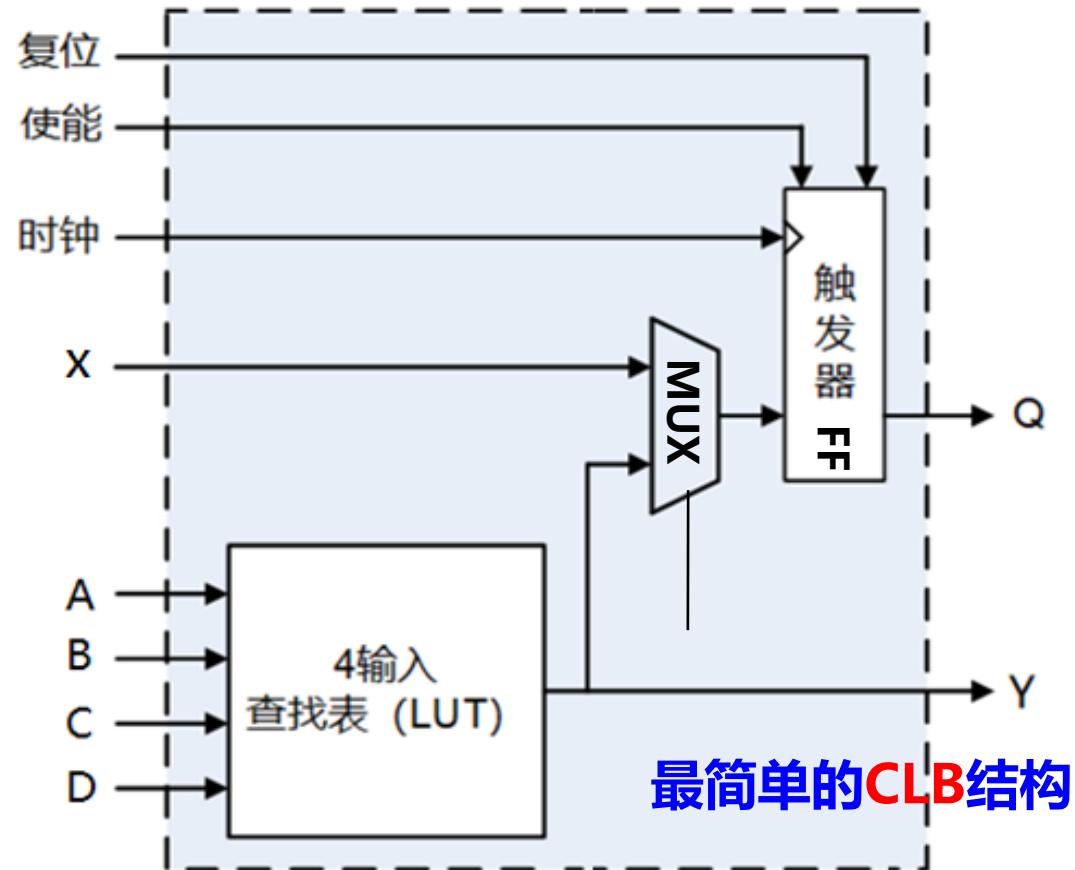


- ◆ 动态存储器DRAM：单MOS管+电容
- ◆ 数据以电荷的形式保存在电容中，电容会放电
- ◆ 因此要定期进行刷新（读出后重新写回）。
- ◆ 优点：电路元件少，功耗小，集成度高，用于构建主存储器
- ◆ 缺点：速度慢，是破坏性读出（需读后再生），需定时刷新



1.3 FPGA设计概述

- ◆ 现场可编程门阵列 (Field Programmable Gate Array, FPGA) 是一种高集成度的复杂可编程逻辑器件，可通过EDA (Electronic Design Automation) 软件对其进行配置和编程，可反复擦写。
- ◆ FPGA内部包含大量可配置逻辑块CLB，它由若干查找表 (Look-Up Table, LUT) 及多路选择器、进位链、触发器FF等附加逻辑组成。
- ◆ 可对CLB进行不同配置。如右图：可编程配置输出为LUT实现的组合逻辑电路的结果Y；也可配置为输出时序逻辑电路的结果Q。
- ◆ LUT多采用SRAM实现。



通过HDL描述逻辑电路后，EDA工具会自动计算逻辑电路所有可能的结果，并以真值表形式事先写入RAM中

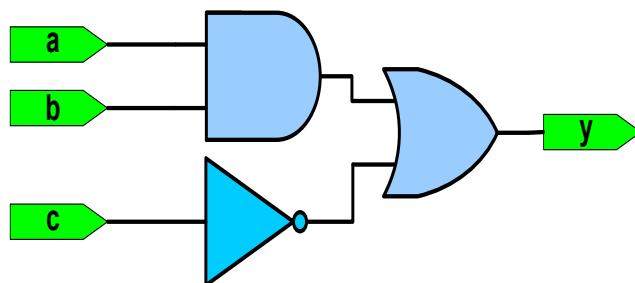
1.3 FPGA设计概述

- ◆ 函数发生器通过**查找表LUT**实现，其中的内容**可编程配置**
 - ◆ LUT存储单元中存放函数输出值，用于实现一个小规模逻辑函数
- 举例：若要实现函数 $f(a,b,c) = ab + \bar{c}$

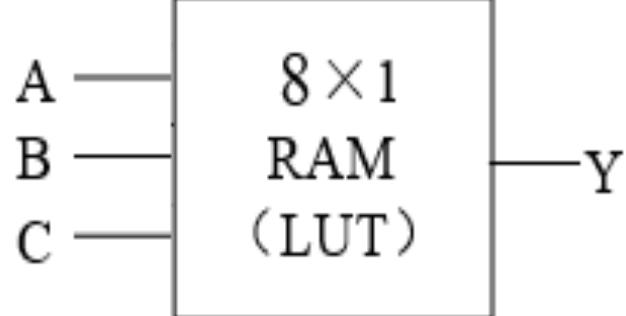
真值表

a	b	c	y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

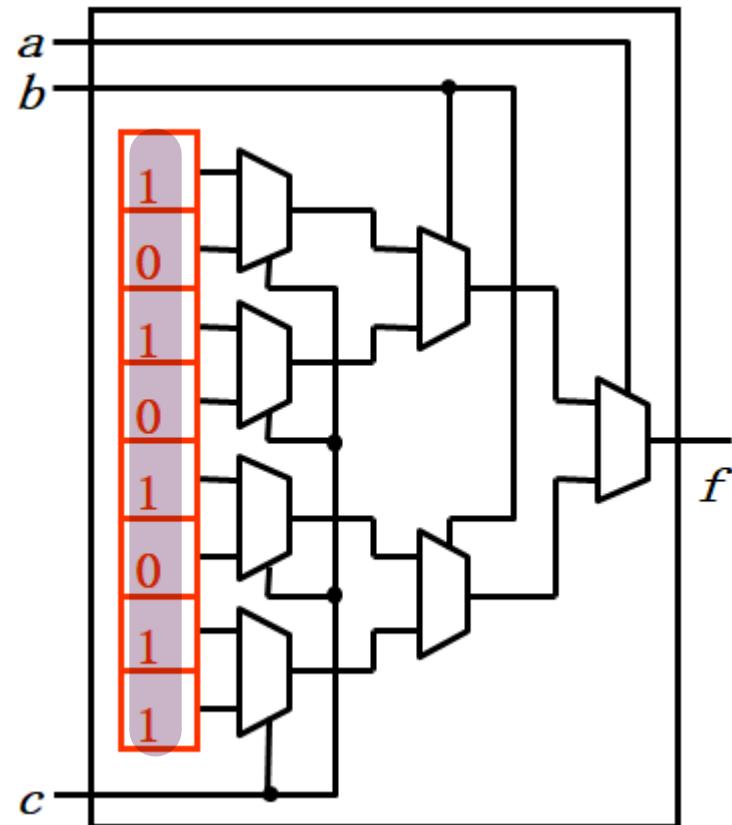
门电路实现



3输入LUT



3输入LUT实现



(*) 1.4 专用集成电路ASIC

- ◆ 专用集成电路 (Application-Specific Integrated Circuit, ASIC) 是一种应特定用户要求和特定电子系统需要而设计、制造的集成电路。
 - 全定制：设计者完成所有设计，速度更快
 - 半定制：使用标准库里的标准逻辑单元（标准单元）
- ◆ FPGA和ASIC目前都是电子设计领域的主流产品。
 - ASIC面向特定用户的需求，具有体积小、功耗低、可靠性高、性能高、保密性高、成本低等优点，一般用于批量大的专用产品中。
 - FPGA可编程特性使其应用非常灵活，但芯片内部逻辑门的使用率大幅降低，导致功耗高、速度慢、资源冗余且价格昂贵，一般用于小批量产品设计中。